

Title (en)
Device for tuning the coupling between two waveguides.

Title (de)
Vorrichtung zum Abstimmen der Kopplung zwischen zwei Hohlleitern.

Title (fr)
Dispositif pour accorder le couplage entre deux guides d'ondes.

Publication
EP 0339404 A1 19891102 (DE)

Application
EP 89106761 A 19890415

Priority
DE 3813812 A 19880423

Abstract (en)
The tuning of the coupling between two waveguides which are separated from one another by a coupling aperture is very tedious with known devices, since no defined change in the coupling level can be achieved with them. A defined tuning of the coupling is ensured by arranging at least one tuning screw (5, 5'), penetrating through the waveguide wall, in front of the coupling aperture (3) in the region of the coupling opening (4, 4'). The device according to the invention is suitable, for example, for use in waveguide filters in order to tune these to a desired characteristic with little effort. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Abstimmung der Kopplung zwischen zwei durch eine Koppelblende voneinander getrennten Hohlleitern ist mit bekannten Vorrichtungen sehr langwierig, da mit ihnen keine definierte Änderung des Kopplungsgrades möglich ist. Eine definierte Abstimmung der Kopplung wird dadurch gewährleistet, daß vor der Koppelblende (3) im Bereich der Koppelöffnung (4, 4') mindestens eine die Hohlleiterwandung durchdringende Abstimmungsschraube (5, 5') angeordnet ist. Die erfindungsgemäße Vorrichtung eignet sich z. B. für den Einsatz in Hohlleiterfiltern, um diese mit geringem Aufwand auf eine gewünschte Charakteristik abstimmen zu können

IPC 1-7
H01P 1/208

IPC 8 full level
H01P 1/208 (2006.01)

CPC (source: EP)
H01P 1/208 (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] US 2649576 A 19530818 - LEWIS WILLARD D
- [A] US 4028651 A 19770607 - LEETMAA JURI G
- [A] US 4251787 A 19810217 - YOUNG FREDERICK A, et al
- [A] US 3748604 A 19730724 - WANG H
- [AD] EP 0131754 A2 19850123 - TELETTRA LAB TELEFON [IT]
- [Y] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 3, Nr. 121 (E-143), 144 E 143; & JP-A-54 99 547 (MITSUBISHI DENKI K.K.) 06-08-1979

Cited by
FR2675952A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)
EP 0339404 A1 19891102; EP 0339404 B1 19930616; DE 3813812 A1 19891102; DE 3813812 C2 19910606; DE 58904688 D1 19930722

DOCDB simple family (application)
EP 89106761 A 19890415; DE 3813812 A 19880423; DE 58904688 T 19890415